

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于签署股权转让协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易概述

2026年3月27日，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》，即公司在取得光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”）20%股权的基础上，拟进一步增加对标的公司的投资，并拟与标的公司股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝集团”）签署《金帝联合控股集团有限公司与苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），即金帝集团拟将其持有的标的公司5,291,005.55元注册资本（占标的公司总股本比例为6.9365%）以13,000万元的价格转让给本公司（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于签署股权转让协议的公告》（公告编号：2025-015）。

### 二、交易进展情况

根据《股权转让协议》约定，本公司前期已向金帝集团支付股权转让总价款的50%（即6,500万元），详见公司于2026年5月26日披露的《关于签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-038）。

近日，根据标的公司股东会决议，金帝集团已将其持有的标的公司6.9365%股权转让至本公司名下，并完成相关工商变更登记手续。同时，公司已按协议约

定支付剩余转让款 6,500 万元。

本次交易完成前,本公司持有标的公司的股权比例为 20%;本次交易完成后,本公司持有标的公司的股权比例为 26.9365%。

### 三、备查文件

1. 相关部门出具的《备案登记情况》;
2. 《银行回单》。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二日